

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

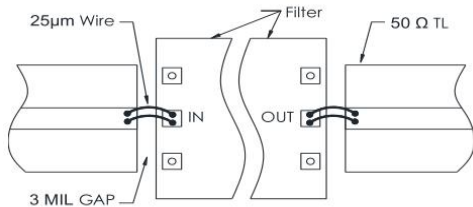
技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		6.0		GHz
工作频率	DC		12.0	GHz
中心损耗		0.4	0.6	dB
截止频率损耗		1.5	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@13.6-16.0GHz	20	25	dBc
	@16.0-22.0GHz	30	35	dBc

环境要求

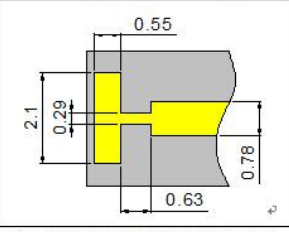
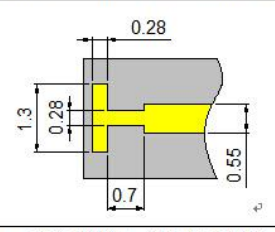
最大输入功率	25	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

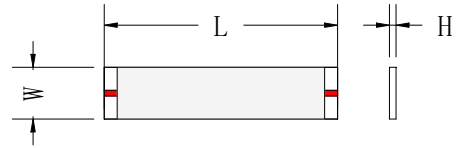


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**2.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

电路板 Rogers 5880, 10mil 厚	电路板 Rogers 4350, 10mil 厚
	
注: T型图形顶端基板白边 0.1mm; 频率 10GHz 以下无需匹配	

外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	4.0	2.0	0.254	mm

典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

